

Noritake

GRINDING SOLUTIONS

研削ソリューション

SEMICONDUCTOR

半導体



工程まるっと、
ノリタケ

SiCパワー半導体製造工程の課題と提案
Issues and Proposals for Improvement of SiC Power Semiconductor Manufacturing Processes

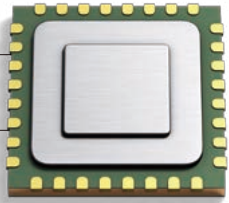
SiCパワー半導体 (8inch) SiC Power Semiconductor (8 inch)

ウェーハ製造工程 SiC Substrate Manufacturing Process

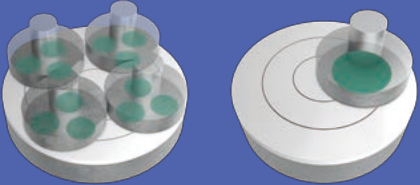
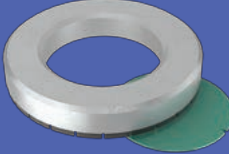
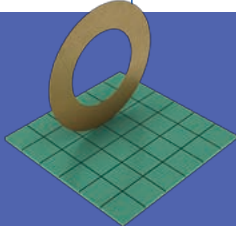


SiCパワー半導体製造工程の課題と提案
Issues and Proposals for Improvement of SiC Power Semiconductor Manufacturing Processes

SiCパワー半導体 (8inch) SiC Power Semiconductor (8 inch)



デバイス製造工程 Device Manufacturing Process

CMP CMP		エッジポリッシュ Edge Polish	裏面研削 Back Grinding	CMP CMP	ダイシング Dicing	パッケージ Package	パッケージダイシング Package Dicing	完成 (8inch品) Final Product (8 inch)
								
加工に時間がかかる Long Processing Time		鏡面化が求められる Require Mirror Polishing	高能率研削 High-Efficiency Grinding				切断品位の持続性が求められる Consistent Cutting Quality	
加工レート向上 High Polishing Rate		表面粗さ向上 Fine Surface Finish	加工コスト低減 Lower Tool Cost				チッピング、斜断発生 Chipping & Oblique Cutting	
ご提案 Proposal		ご提案 Proposal	ご提案 Proposal				ご提案 Proposal	
 半固定砥粒パッド LHAパッド LHA Pad		 半固定砥粒パッド【開発中】 LHA Pad For Edge	 ダイヤモンドホイール Diamond Wheel				 ダイシングブレード Dicing Blade	
 ノリタケルブリカント LSC-1 Noritake Lubricant LSC-1								
 遠心分離機 Centrifugal		 セラミックフィルター Ceramic Filter	 セラミックフィルター Ceramic Filter				 セラミックフィルター Ceramic Filter	

Noritake

お問合せはこちら
Contact Us



ノリタケ株式会社
NORITAKE CO., LIMITED

www.noritake.co.jp



改良にともない、お断りなく仕様など変更させていただくことがあります。
The contents are subject to change without notice.

20261000SK